●2026 年度精密工学会秋季大会特別シンポジウム 第 5 弾 （参加費無料，事前申込制）

「半導体製造装置開発の最前線」

～業界トップクラスの技術者が登壇 技術をわかりやすく解説します～

半導体産業は、生成 AI や自動運転、社会インフラを支える不可欠な基盤です。特に製造技術は、アイデアを実用化し、半導体の性能・省電力・コストを決定づける競争力の源泉となっています。その製造技術はデジタル半導体だけでなく、電気を効率的に制御するパワー半導体や、光・センサーなどのアナログ半導体の進化も支えています。

本シンポジウムは、日本半導体製造装置協会（SEAJ）との共同開催で、半導体製造に関わる世界トップレベルの研究者・技術者にご講演いただきます。

はじめに、基調講演としてキオクシア岩手株式会社の常務取締役 神垣哲也氏より『beyond the imagination～AI インフラの中核を担う フラッシュメモリ～』と題してご講演を頂きます。

シンポジウムでは半導体製造技術の研究・開発の最前線のご講演を御三方から頂きます。

研究者・技術者の方々には、様々な点で興味深いニーズやシーズを見つけていただけると思います。また、学生の皆さんにはこの分野の魅力やわくわく感を感じていただけると思います。本講演が日本半導体製造装置協会と精密工学会との繋がりの機会になれば幸いです。

日 時：2026 年 9 月 15 日（火） 14:20～16:30 （受付開始：13:50～）
会 場：東北大学 川内キャンパス マルチメディアホール （秋季大会会場内）
司 会：岩本花子（株式会社 SCREEN セミコンダクターソリューションズ）

次 第：

時 間	題 目	内 容	講 師
14:20	主催者挨拶	精密工学会より	精密工学会会長 吉田 均
基調講演			
14:25～15:05	beyond the imagination ～AI インフラの中核を担う フラッシュメモリ～		キオクシア岩手株式会社 常務取締役 神垣 哲也
シンポジウム			
15:05～15:25	半導体製造装置の変遷から将来の技術動向を予想する	概要：半導体製造工程は、リソグラフィ、成膜、エッチング、不純物導入、熱処理、平坦化、洗浄などを複雑に繰り返すことで成り立っている。その劇的な変遷を振り返ることから将来の技術動向を予想する。	株式会社 SCREEN セミコンダクターソリューションズ Senior Process Technology Adviser 増本 哲己
15:25～15:45	ナノインプリントリソグラフィの現状と応用	概要：ナノインプリントリソグラフィの歴史や背景、半導体露光装置としての現状を説明する。また、半導体用途以外でも様々なところに応用されており、製品化や今後の出口候補などについて紹介する。	東京理科大学 先進工学部 教授 谷口 淳
15:45～16:05	半導体の 3D 構造化を支える接合技術	概要：半導体は 2D の微細化に加えて 3D 構造化へと進化の方向を広げている。本講演では、その実現を支える接合技術に着目し、その必要性や技術の変遷、現状、今後の展望について紹介する。	東京エレクトロン株式会社 コーポレート製品開発本部 開発担当 GM 岩元 勇人
16:05～16:20	Q&A セッション	質疑応答など、不明なところや疑問点を説明します （スマートフォンアプリ“Slido”を用います）	本日の講師とともに
16:20～16:25	共催挨拶	日本半導体製造装置協会より	日本半導体製造装置協会 専務理事 渡部 潔
16:25～16:30	閉会の挨拶	半導体製造技術ネットワーク分科会より	分科会主査 長谷川 功宏

【連携企画】 新技術講演会（ものづくり賞受賞講演）：16:45～18:00
同日 16:45 から同会場にて「新技術講演会（精密工学会ものづくり賞受賞講演）」を予定しています。併せてご参加ください。

主催：公益社団法人 精密工学会（JSPE）
共催：一般社団法人 日本半導体製造装置協会（SEAJ）
参 加 費：無料，事前申込制
申込方法：ホームページ（ https://2026-09autumn.jspe.or.jp/semiconductor-sympo/ ）
または、右の QR コードからお申込み下さい.
申込み期限：2026 年 9 月 4 日（金）
申 込 先：公益社団法人 精密工学会（URL：https://www.jspe.or.jp/）

お申込み